令和　年　　月　　日

知的財産権実施許諾同意申請書

国立研究開発法人日本医療研究開発機構　殿

（代表者又は知的財産権の譲渡等の権限を有する者）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 研究機関名 | ： |  |
| 所属 役職 | ： |  |
| 氏名 | ： |  |

　　機構が共有する知的財産権の実施許諾を下記の者が求めているので、実施権許諾の同意をお願いしたく申請します。

 記

　１．実施しようとする知的財産権

|  |  |
| --- | --- |
| 知的財産権の種別（注１）及び番号（注２） | 名称（注３） |
|  |  |

 ２．実施許諾を求める者

（住所）

（会社名）

３．実施期間　　 自　令和　年　　月

 　　 　 至 令和　年　　月

 ４．開発実施計画等　　（１）開発実施計画書　別添１

 　　　　　　　　　　　（２）経歴書　　　　　別添２

 ５．申請する実施権の種類（非独占的実施権、一部独占実施権、独占実施権等を記載）

別添１

開発実施計画書

（住所）

（会社名）

１．特許権等

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 特許等出願又は登録番号 | 出願年月日 | 発明等の名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |

２．申請理由等

（注）次の事柄を盛り込んで記載してください。

（１）　貴社の設立時期、及び業界での地位、特徴

（２）　本新技術に関連する技術的背景、研究実績

（３）　本新技術の用途・目的及び本新技術に対する技術的、経済的評価

（４）　本技術に対して実施を申し込む内容

（５）　本技術に対して実施を申し込む必要性

（６）　本技術について情報を入手した経緯（論文を読んだ、研究者から聞いた等）

３．実施計画

（１）　実施予定場所

（社名・工場名）

（住所）

（電話番号）

（２）製造品目及び用途

製造品目：

用途：箇条書きで記載してください。

（注）製造工程図、装置構成図等を使ってわかりやすく記載してください。

（３）開発期間及び開発所要資金

△年□か月

千円

４．開発終了後、３か年の利益予想表

（単位：千円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度項目 | １年度 | ２年度 | ３年度 | 合計 |
| 販売数量 |  |  |  |  |
| （販売単価） |  |  |  |  |
| 販売高 |  |  |  |  |
| 総原価 |  |  |  |  |
| 利益 |  |  |  |  |

（注）年度は、開発終了後１年目、２年目、３年目を意味します。

５．財政の状況（令和　年　　月　　日現在）

主要取扱い品目

資本金

総資産

売上高

従業員数

利益

配当

６．その他

別紙２

経　歴　書

 　(1) 定款

 　(2) 会社経歴書

 　(3)　営業業種（工業統計分類４桁分類による）

 　(4) 生産能力

 　(5) 貸借対照表 （直近年度）

 　(6) 損益計算書 （直近年度）

 　(7) 資本金 （直近年度）

 　(8) 従業員数 （直近年度）

（注意事項）

（注１）特許権又は特許を受ける権利、実用新案権又は実用新案権を受ける権利、意匠権又は意匠を受ける権利、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち該当するものを記載してください。

（注２）当該種類に係る出願番号又は設定登録番号を記載してください。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号（管理番号を付している場合）を記載してください。ノウハウについては、管理番号（管理番号を付している場合）を記載してください。なお、外国における権利である場合は、当該番号に国名又は機関名（国コードでも可）を併記してください。

（注３）特許権又は特許を受ける権利については発明の名称、実用新案権又は実用新案を受ける権利については考案の名称、意匠権又は意匠を受ける権利については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称、プログラム等著作権については著作物の題号、ノウハウはノウハウの名称を記載してください。

（注４）移知的財産権が複数ある場合は、まとめて記載することができます。